



中华人民共和国国家军用标准

FL 6124

GJB 33/18-2011

半导体光电子器件 GO417 型双向半导体光电耦合模拟开关 详细规范

Semiconductor optoelectronic device—
Detail specification for type GO417 bidirectional analog switch
semiconductor photocoupler

2011-12-25 发布

2012-04-01 实施

中国人民解放军总装备部 批准

目 次

前言	II
1 范围	1
2 引用文件	1
3 要求	1
3.1 总则	1
3.2 质量保证等级	1
3.3 设计、结构和材料	1
3.4 绝对最大额定值和主要光电特性	1
3.5 标志	3
4 质量保证规定	3
4.1 检验分类	3
4.2 筛选	3
4.3 鉴定检验	4
4.4 质量一致性检验	4
4.5 芯片评价与控制	7
4.6 用户监制	7
4.7 用户验收	7
4.8 破坏性物理分析(DPA)	7
5 交货准备	7
5.1 包装要求	7
5.2 储存要求	7
5.3 运输要求	7
6 说明事项	7
6.1 预定用途	7
6.2 订购文件应明确的内容	7
6.3 失效处理	7
6.4 重大工艺更改	7
6.5 储存寿命	7
附录 A (规范性附录) 稳态工作寿命试验方法	8
附录 B (规范性附录) 电特性的测试方法	9
附录 C (规范性附录) 芯片评价与控制	11
附录 D (资料性附录) 用户监制	12
附录 E (资料性附录) 用户验收	13
附录 F (规范性附录) 破坏性物理分析(DPA)	14

前 言

本规范是 GJB 33A-1997《半导体分立器件总规范》的相关详细规范。

本规范的附录 A、附录 B、附录 C 和附录 F 是规范性附录，附录 D 和附录 E 是资料性附录。

本规范由中国人民解放军总装备部电子信息基础部提出。

本规范起草单位：苏州半导体总厂有限公司、工业和信息化部电子第四研究所、中国航天科技集团公司第一研究院。

本规范主要起草人：宁雪英、陈明园、陈 兰、赵 英、熊盛阳。